

## 車載部品・センサー

Automotive Devices/Sensor



## 通信インフラ・基地局

Communication Infrastructure/  
Base Station



### 用途

Applications

#### ●プリント配線板(コネクタ部)

Printed wiring board (Connector parts)

#### ●コネクタ用フレキシブル基板

Flexible substrate for connector

#### ●成型コネクタ

Molded connector

## PC・サーバー

PC/Server



## スマートフォン・カメラ

Smartphone/Camera



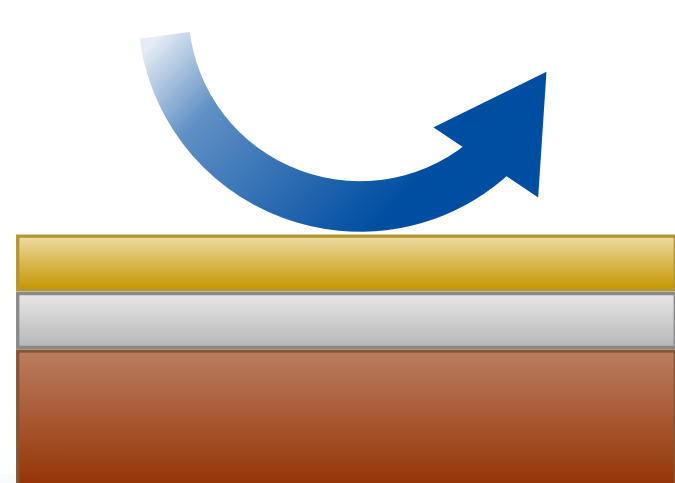
●はJPCの金めっき技術が使われています。  
Apply JPC's Gold Plating Technology.

## 世界中で使用されているJPCの金めっき技術

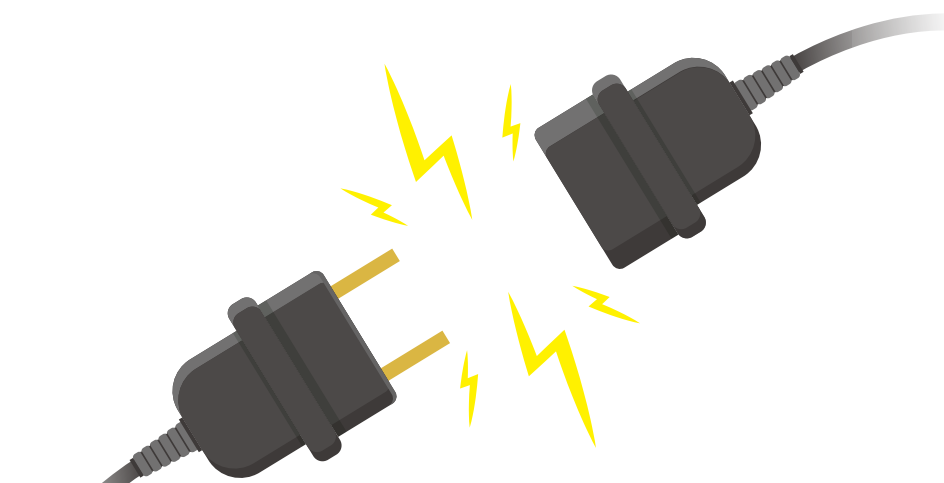
JPC's Gold Plating Technology used around the world

信頼と安定の金めっき技術 ～高品質な金めっき皮膜形成～

Reliable and Stable Gold Plating Technology "High-quality Gold Plating Film Manufacturing"



耐食性・耐摩耗性  
Corrosion/Abrasion Resistance



低接触抵抗  
Lower Contact Resistance  
優れた性能の維持  
Maintain Excellent Performance



優れたはんだ濡れ性  
Excellent Solder Wettability



高速めっき対応  
High Speed & Throughput Plating  
優れた生産性  
Excellent Productivity





## JPCの金めっき液により コスト削減が可能です

Allow significant cost reduction  
using JPC's gold plating formulation



製品全体に金めっきした場合、  
無駄な金を使用してしまう

When applying gold plating in all over,  
face rising cost due to extra  
gold plating deposition.



理想的な  
金めっきエリアを実現

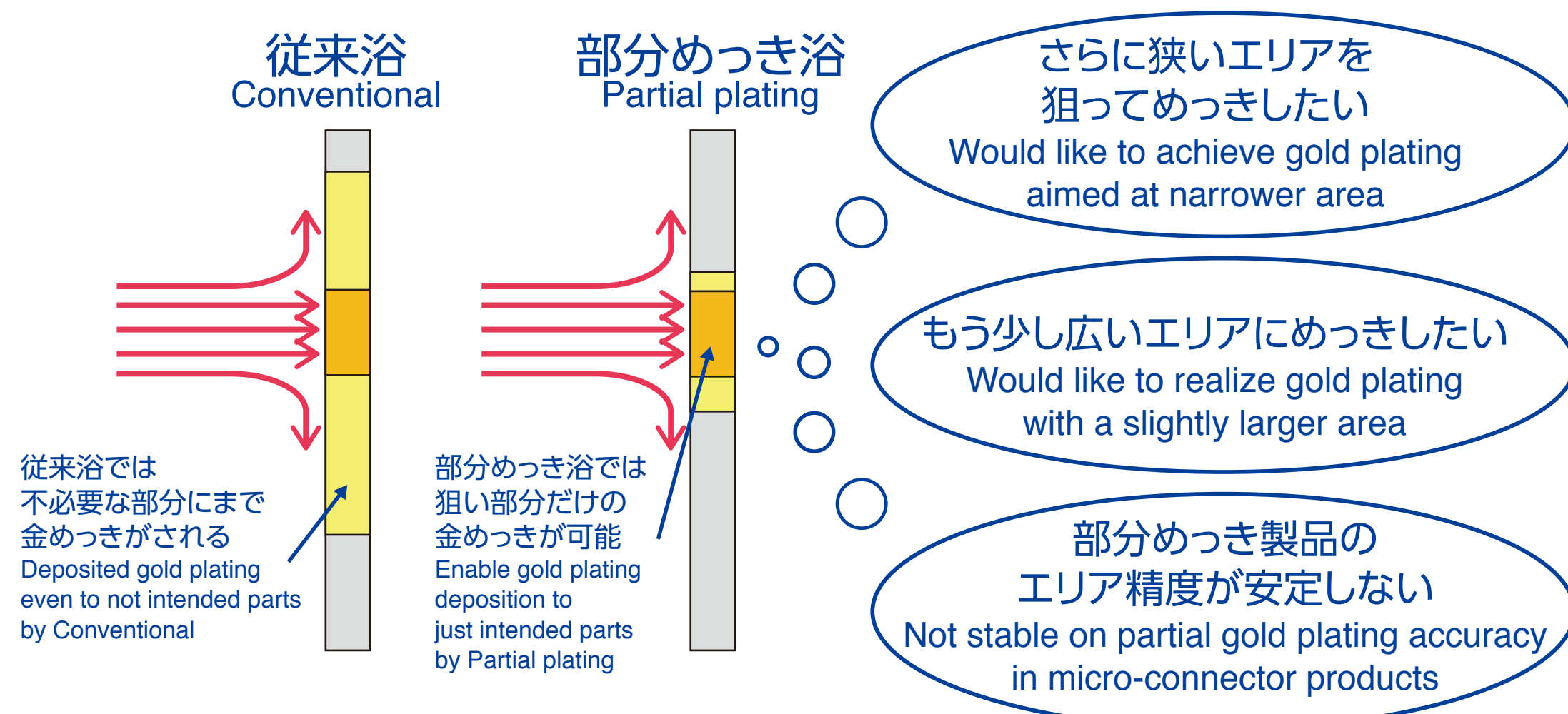
Achieve ideal gold plating  
deposition area.

## JPCの金めっき液の特徴：部分めっき技術とニッケルバリア技術

Features of JPC's gold plating formulation : partial plating technology and nickel barrier technology

### オーロブライトBAR7：金めっきエリアのコントロール

OROBRIGHT BAR7 : Regarding gold Plating Area Control



薬品濃度 Agent concentration.	0%	20%	50%	100%	200%
コネクタ外観 Connector Appearance					

薬品濃度を変更することで金めっきエリアを自由に調整可能  
Control on gold plating deposition area by adjusting agent concentration.



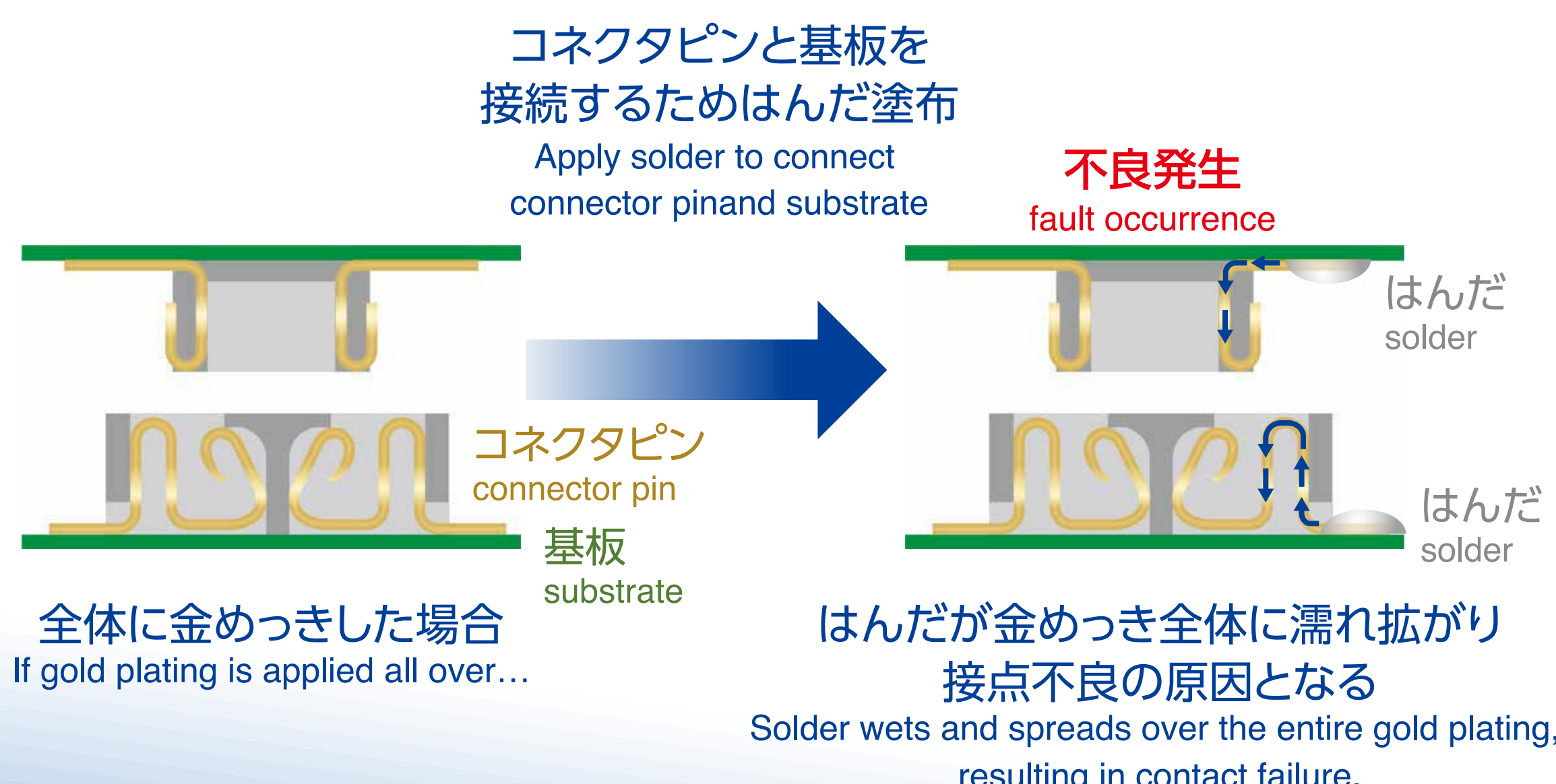
ランニング時の薬剤濃度を  
正確にコントロールするためには  
簡単で高精度な分析方法が必要  
To achieve excellent control for agent  
concentration during running,  
Need simple and excellent analysis  
method.



JPCのめっき液は JPC's formulation is

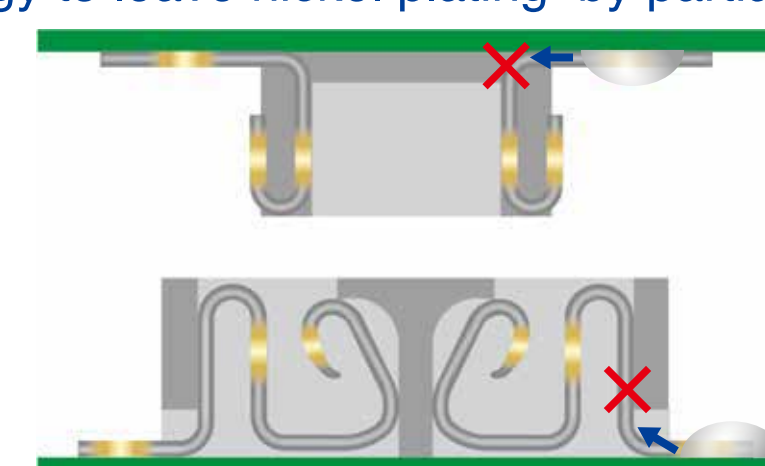
1. 高精度な分析管理ができる  
High accuracy analysis
2. 現場で簡単に分析ができる  
Excellent repeatability
3. 短時間での分析ができる  
Easy and Quick analysis

## ニッケルバリア技術とは What is nickel barrier technology?



### ニッケルバリア技術 Nickel barrier technology

金めっきを部分めっきにすることで  
ニッケルめっき部分を残す技術  
Technology to leave nickel plating by partial gold plating



はんだ濡れ拡がり  
がニッケルで止まるため  
接点不良とならない(ニッケルバリア)  
Contact failure does not occur because  
solder wetting and spreading stops at nickel  
(Nickel barrier).